

**苏州锴威特半导体股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市**

**发行结果公告**

**保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司**

**特别提示**

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1512号）。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“锴威特”，扩位简称为“苏州锴威特”，股票代码为“688693”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为40.83元/股，发行数量为18,421,053股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为921,052股，占本次发行数量的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为921,052股，占本次发行数量的5.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为12,250,001股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为5,250,000股，占

扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 17,500,001 股。

根据《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,151.27 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,750,500 股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 10,499,501 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 9,445,388 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 1,054,113 股；网上最终发行数量为 7,000,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04231394%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）结束。

## 一、新股认购情况统计

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### 1、战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为保荐人相关子公司（华泰创新投资有限公司）跟投。

截至 2023 年 8 月 3 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已在 2023 年 8 月 14 日（T+4 日）之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股数占本 次发行数量的 比例 (%)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	华泰创新投资有 限公司	保荐人相关子公 司	92.1052	5.00	37,606,553.16	24个月

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

## 2、网上新股认购情况

- (1) 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,944,274
- (2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：283,534,707.42
- (3) 网上投资者放弃认购数量（股）：56,226
- (4) 网上投资者放弃认购金额（元）：2,295,707.58

## 3、网下新股认购情况

- (1) 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,499,501
- (2) 网下投资者缴款认购的金额（元）：428,694,625.83
- (3) 网下投资者放弃认购数量（股）：0
- (4) 网下投资者放弃认购金额（元）：0

## 二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,054,113股，占网下发行总量的10.04%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.02%。

## 三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为56,226股，包销金额为2,295,707.58元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.32%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为

0.31%。

2023年8月14日（T+4日），主承销商将余股包销资金与参与战略配售的投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

#### 四、本次发行费用

本次发行费用总额为 8,733.27 万元：

- 1、保荐及承销费：6,066.63 万元；
- 2、审计验资费用：1,380.00 万元；
- 3、律师费用：781.32 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：443.40 万元；
- 5、发行手续及材料制作费用：61.92 万元。

注：本次发行各项费用及总额均为不含增值税金额。与《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中发行手续费及材料制作费用差异原因系根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及材料制作费用。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

#### 五、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839478

联系地址：北京市西城区丰盛胡同丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人：苏州锴威特半导体股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年8月14日

（此页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司



2023年8月14日

（此页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

